

## कम्पन का मापन Measurement of Vibration

लघु '3r' : अतिव्यु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1. कम्पन वेज का प्रयोग कब किया जाता है?

उत्तर जब कभी कम्पनों का आयाम 1 mm से अधिक होता है तो कम्पन मापन के लिए कम्पन वेज का प्रयोग किया जाता है।

प्रश्न 2. ज्यावकीय कम्पन का विस्थापन समीकरण लिखिए।

उत्तर  $x = X \sin \omega t$ , जहाँ X कम्पन का आयाम,  $\omega$  कम्पन की आवृत्ति तथा x कण का t समय पर विस्थापन है।

प्रश्न 3. साइन वक कम्पनों को समझने के लिए किसकी आवश्यकता होती है?

उत्तर साइन वक कम्पनों को समझने के लिए आयाम तथा आवृत्ति या अधिकतम वेग व अधिकतम त्वरण की आवश्यकता होती है।

प्रश्न 4. कम्पनों का मापन किसके द्वारा किया जा सकता है?

उत्तर -कम्पनों का आयाम, वेग या त्वरण को उपयुक्त ट्रांसड्यूसर की सहायता से ज्ञात कर कम्पनों का मापन किया जा सकता है।

प्रश्न 5. कम्पनों की आवृत्ति किस युक्ति के द्वारा ज्ञात की जा सकती है?

उत्तर डिजिटल आवृत्ति मीटर की सहायता से।

प्रश्न 6. कम्पन वेज के टुकड़े के सिरे का आकार कैसा होता है?

उत्तर कम्पन वेज का टुकड़ा एक सिरे पर चौड़ा तथा दूसरे सिरे पर नुकीला होता है।

प्रश्न 7. कम्पनों की आवृत्ति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है?

उत्तर कम्पनों की आवृत्ति ज्ञात करने के लिए कैंटिलीवर बीम का प्रयोग किया जाता है।

प्रश्न 8. भूकम्पी त्वरणमापी में प्रयोग किए जाने वाले पिण्ड को क्या कहते हैं?

उत्तर भूकम्पी त्वरणमापी में प्रयोग किए जाने वाले पिण्ड को भूकम्पी द्रव्यमान कहते हैं।

प्रश्न 9. LVDT त्वरणमापी किस पर आधारित होता है?

उत्तर LVDT त्वरणमापी रेखाय वोल्टेज विभेदी ट्रांसफार्मर पर आधारित होता है।

प्रश्न 10. पीजे-इलेक्ट्रिक क्रिस्टल कम्पनों के प्रति कैसे होते हैं?

उत्तर असंयत सुश्राही।

लघु 'ब' : लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1. कम्पन की परिभाषा दीजिए तथा इसके कारण बताइए।

उत्तर जब कभी किसी वस्तु का विस्थापन-समय (displacement-time) परिवर्तन सतत रूप से किसी विशेष प्रकृति का होता रहे तो इस घटना को कम्पन कहते हैं।

कम्पन के प्रमुख कारण निम्न हैं—

1. कम्पन का सामान्य कारण 'असंतुलन' (imbalance) होता है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब घूर्णन गति करते हुए अवयव का गुरुत्व केन्द्र घूर्णन अक्ष पर न हो। इस समस्या को दूर करने के लिए संतुलन द्रव्यमान प्रयोग किए जाते हैं।

2. सामान्य कारणों में मशीन अवयवों की 'सरेखन त्रुटि' (errors in alignment) भी कम्पन का प्रमुख कारण है। इसको दूर करने के लिए पुनः सरेखन करना चाहिए।

3. जब कभी मशीन के चाल अवयव की चाल कम्पन की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाती है तो कम्पन का आयाम बहुत अधिक बढ़ जाता है, इस घटना को 'अनुनाद' (resonance) कहते हैं। चाल अवयव की यह चाल क्रांतिक चाल (critical speed) कहलाती है। मशीन के स्थिर नियतांक (K) तथा सीसिक द्रव्यमान (m) का संशोधन करके कम्पन की स्वाभाविक आवृत्ति ( $\omega = \sqrt{K/m}$ ) में परिवर्तन किया जा सकता है।

4. 'घिसी हुई बॉल बियरिंग' (wornout ball bearing) के प्रयोग से उच्च चाल पर कम्पन उत्पन्न होने लगते हैं। इसके लिए बॉल बियरिंगों को निश्चित समय पर बदल देना चाहिए।

5. रोटर की कुण्डली 'शॉर्ट सर्किट' (short circuit) होने पर भी कम्पन उत्पन्न करती है। रोटर को बिजली आपूर्ति बन्द करने पर कम्पन भी बन्द पड़ जाते हैं; अतः कुण्डली को जाँच कर लेनी चाहिए।

प्रश्न 2. त्वरणमापी से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर किसी कम्पन के विस्थापन या वेग को अवकलित करके कम्पनों का त्वरण ज्ञात कर लिया जाता है। त्वरण ज्ञात करने की यह अप्रत्यक्ष विधि कहलाती है। ये युक्तियाँ जो कम्पनों के त्वरण का मापन कर उनके सतत वोल्टेज आउटपुट उत्पन्न करती हैं, त्वरणमापी कहलाती हैं। अतः त्वरणमापी, त्वरण ज्ञात करने की एक प्रत्यक्ष विधि होती है।

हमारा शरीर कम्पन का अनुभव अत्यंत आसानी से कर लेता है। हम 300 Hz आवृत्ति तथा 0.025  $\mu\text{m}$  आयाम वाले कम्पनों को अनुभव कर सकते हैं। जब कभी कम्पनों का आयाम 1 mm से अधिक होता है तो कम्पन मापन के लिए 'कम्पन वेज' (vibrating wedge) का प्रयोग किया जाता है। कम्पन वेज कागज या बहुत पतले पदार्थ का एक छोटा टुकड़ा (piece) होता है जो एक सिरे पर चौड़ा तथा दूसरे सिरे पर नुकीला होता है। इसके चौड़े सिरे को कम्पन करती हुई वस्तु के साथ इस प्रकार लगा दिया जाता है कि इसकी अक्ष वस्तु की सतह के साथ लम्बवत् रहती है। कम्पन करते समय वेज की दृश्यता (visibility) अच्छी बनी रहे इसके लिए इसे गहरे रंग का बनाया जाता है।

प्रश्न 3. एक भूकम्पी त्वरणमापी की कार्य पद्धति समझाइए।

(2011, 13, 14)

उत्तर कम्पनों को मापने के लिए विभिन्न उपकरणों के नाम लिखिए। किसी एक की व्याख्या स्वच्छ चित्र की सहायता से कीजिए।

(2016)

अथवा सिसिक एक्सेलेरोमीटर पर टिप्पणी लिखिए।

(2016, 18)

अथवा सिसिक-त्वरणमापी (Seismic accelerometer) पर संक्षिप्त नोट लिखिए।

(2016)

उत्तर एक कम्पन सिस्टम में जिन राशियों को मापने की आवश्यकता होती है, वे हैं—विस्थापन, गति तथा त्वरण। इनको निम्नलिखित उपकरणों के माध्यम से मापा जाता है—

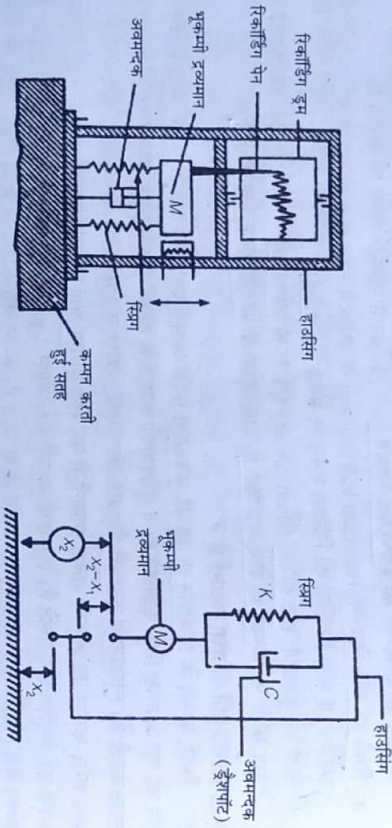
1. भूकम्पी ट्रांसड्यूसर,
2. पोटेंशियोमीट्रिक प्रारूपी त्वरणमापी,
3. दाब-विद्युत त्वरणमापी।

4. LVDT त्वरणमापी, कई प्रकार के कम्पन मापन यंत्रों द्वारा, स्थिर सन्दर्भ की अनुपस्थिति में, सापेक्ष विस्थापन (relative displacement) का मापन करने में कठिनाई आती है। इस प्रकार की कठिनाईयों युक्त (bridge), निर्माण (structure) तथा हवाई जहाज के पंख (wings) के कम्पन मापन में मापने आती हैं। अतः इस प्रकार का कम्पन मापन भूकम्पी त्वरणमापी द्वारा किया जाता है।

भूकम्पी त्वरणमापी कम्पनों के मापन के लिए सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली युक्ति है। भूकम्पी त्वरणमापी में अग्र प्रमुख अवयव प्रयोग किए जाते हैं—

- (iv) भूकम्पी द्रव्यमान (Seismic mass),  
 (v) अवमन्दक (Damper),  
 (vi) रिकॉर्डिंग ड्रम (Recording drum),  
 (vii) विद्युत ट्रांसड्यूसर (Electrical transducer)  
 (viii) स्प्रिंग (Spring),  
 (ix) हाउसिंग (Housing),  
 (x) रिकॉर्डिंग पेन (Recording pen) तथा,  
 (xi) विद्युत ट्रांसड्यूसर (Electrical transducer)

भूकम्पी त्वरणमापी में प्रयोग किए जाने वाले पिण्ड को भूकम्पी द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान का सम्बन्ध स्प्रिंग व अवमन्दक के समान्तर क्रम संयोजन से रहता है। स्प्रिंग व अवमन्दक त्वरणमापी की हाउसिंग से जुड़े रहते हैं। एक रिकॉर्डिंग पेन भूकम्पी के द्रव्यमान से जुड़ा रहता है, तथा कम्पनों को रिकॉर्डिंग ड्रम पर रिकॉर्ड करता रहता है। भूकम्पी द्रव्यमान एक ट्रांसड्यूसर से भी जुड़ा रहता है जहाँ पर कम्पनों को विद्युत-सिगनल में परिवर्तित किया जाता है।



चित्र 9.1 भूकम्पी त्वरणमापी

हाउसिंग को कम्पन करती हुई वस्तु पर लगा दिया जाता है जिससे हाउसिंग कम्पन करने लगती है। जड़त्व के कारण द्रव्यमान स्थिर रहता है, इसलिए हाउसिंग द्रव्यमान के सापेक्ष कम्पन करने लगती है। परंतु यह एक आदर्श स्थिति है जिसमें द्रव्यमान स्थिर रहता है। वास्तव में हाउसिंग के कम्पन करने पर द्रव्यमान भी स्प्रिंग व अवमन्दक के प्रभाव में कम्पन करने लगता है। कम्पनों का आउटपुट हाउसिंग व द्रव्यमान के मध्य सापेक्ष गति पर निर्भर करता है।

माना  $M =$  भूकम्पी द्रव्यमान (kg),  
 $b =$  अवमन्दन नियतांक (kg/s),  
 $k =$  स्प्रिंग बल नियतांक (N/m),  
 $X_1 =$  हाउसिंग का किसी क्षण विस्थापन (m),  
 $X_2 =$  भूकम्पी द्रव्यमान का किसी क्षण विस्थापन (m),  
 तथा  $x_1 = X_1 \cos \omega_1 t$ , जहाँ  $\omega_1$  कम्पनों की आवृत्ति है तो बल का समीकरण निम्न रूप में लिखा जा सकता है—

$$M \ddot{x}_2 + b \dot{x}_2 + kx_2 = b \dot{x}_1 + kx_1$$

$$M \ddot{x}_2 + b \dot{x}_2 + kx_2 = -bX_1 \omega_1 \sin \omega_1 t + kX_1 \cos \omega_1 t$$

या उपरोक्त समीकरण का हल

$$x_1 - x_2 = e^{-\frac{b}{2M}t} \left[ A \cos \omega_1 t + B \sin \omega_1 t \right] + \frac{MX_1 \omega^2 \cos(\omega_1 t + \phi)}{[(k - M\omega_1^2)^2 + b^2 \omega_1^2]^{1/2}} \dots (i)$$

जहाँ,  $(x_2 - x_1) =$  द्रव्यमान का हाउसिंग के सापेक्ष विस्थापन,  $\omega_d =$  अवमन्दित दोलनों की आवृत्ति,  $A$  तथा  $B$  नियतांक हैं।  $A$  तथा  $B$  के मान सीमाओं को लगाने पर प्राप्त हो जाते हैं। अवमन्दित दोलनों की आवृत्ति,

$$\omega_d = \left\{ \frac{k}{M} - \left( \frac{b}{2M} \right)^2 \right\}^{1/2}$$

तथा इनपुट सिगनल व आउटपुट सिगनलों के मध्य कालान्तर,

$$\phi = \tan^{-1} \frac{b\omega_1}{k - M\omega_1^2}$$

समीकरण (ii) का पहला पद केवल कम्पनों के संक्रमण काल (transient period) तक रहता है। स्थायी अवस्था (steady state) आने पर कम्पन समीकरण के दूसरे पद के अनुसार सम्पन्न होते हैं। अतः स्थायी अवस्था का पद

$$x_2 - x_1 = \frac{MX_1 \omega^2 \cos(\omega_1 t + \phi)}{[(k - M\omega_1^2)^2 + b^2 \omega_1^2]^{1/2}}$$

यदि  $(x_2 - x_1)$  के सापेक्ष विस्थापन का आयाम  $X_M$  है तो आयाम

$$X_M = \frac{MX_1 \omega_1^2}{[(k - M\omega_1^2)^2 + b^2 \omega_1^2]^{1/2}}$$

या

$$X_M = \frac{X_1 \omega_1^2}{\left[ \left( \frac{k}{M} - \omega_1^2 \right)^2 + \left( \frac{b}{M} \right)^2 \omega_1^2 \right]^{1/2}}$$

या

$$\frac{X_M}{X_1} = \frac{\omega_1^2}{\left[ \left( \frac{k}{M} - \omega_1^2 \right)^2 + \left( \frac{b}{M} \right)^2 \omega_1^2 \right]^{1/2}} \dots (iii)$$

परन्तु कम्पनों की स्वाभाविक आवृत्ति,

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{M}} \text{ rad/s}$$

तथा अवमन्दन अनुपात (damping ratio),

$$\xi = \frac{\text{अवमन्दन नियतांक}}{\text{क्रांतिक अवमन्दन नियतांक}} = \frac{b}{2M\omega_n} = \frac{b}{2M \sqrt{\frac{k}{M}}} = \frac{b}{2\sqrt{kM}}$$

अतः क्रांतिक अवमन्दन नियतांक का मान भूकम्पी द्रव्यमान तथा स्प्रिंग बल नियतांक पर निर्भर करता है। अतः समीकरण (iii) को पुनः लिखने पर,

विस्थापन अनुपात,

$$X_M = \frac{\left(\frac{\omega_l}{\omega_n}\right)^2}{\left[1 - \left(\frac{\omega_l}{\omega_n}\right)^2\right]^2 + 2\xi^2 \left(\frac{\omega_l}{\omega_n}\right)^2} \quad \dots (iv)$$

तथा कला कोण,

$$\phi = \tan^{-1} \frac{2\xi \left(\frac{\omega_l}{\omega_n}\right)}{1 - \left(\frac{\omega_l}{\omega_n}\right)^2} \quad \dots (v)$$

**प्रश्न 4. एक विभवमापी प्रकार के त्वरणमापी के प्रयोग का वर्णन कीजिए।**

**उत्तर** विभवमापी प्रकार के त्वरणमापी की रचना सभी त्वरणमापियों में सबसे सरल होती है। भूकम्पी द्रव्यमान स्प्रिंग व अवमन्दक डैशपोर्ट से जुड़ा रहता है। स्प्रिंग व डैशपोर्ट त्वरणमापी के हाउसिंग फ्रेम से दृढ़तापूर्वक जुड़े रहते हैं। द्रव्यमान पर लगा वाइपर प्रतियोग विभवमापी पर सरकने के लिए स्वतंत्र रहता है। हाउसिंग फ्रेम के संपर्क द्रव्यमान का विस्थापन विभवमापी द्वारा वोल्टेज आउटपुट के रूप में पढ़ लिया जाता है।

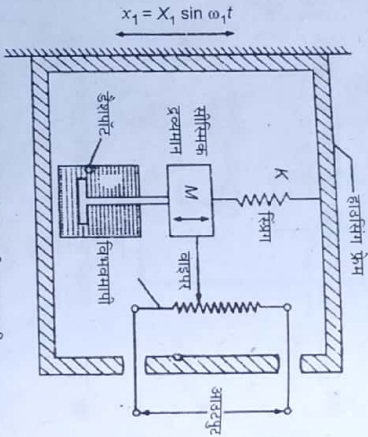
त्वरणमापी में अवमन्दक का कार्य करने के लिए हाउसिंग को स्थान द्रव (viscous liquid) से भर दिया जाता है या फिर डैशपोर्ट का प्रयोग किया जाता है। उपयुक्त अवमन्दक के प्रयोग से आवृत्ति का परास बढ़ाया जाता है। विभवमापी त्वरणमापी की स्वाभाविक आवृत्ति लगभग 100 Hz होती है, इसलिए विभवमापी त्वरणमापी 50 Hz आवृत्ति तक के कम्पनों का मापन करने के लिए उपयुक्त होता है जिससे कि  $\omega/\omega_n$  का अनुपात 2 प्राप्त हो सके। अतः यह उपकरण कम आवृत्ति के कम्पनों का मापन करने के लिए उपयुक्त होता है।

**प्रश्न 5. LVDT प्रकार के त्वरणमापी के प्रयोग का वर्णन कीजिए। इसके लाभ भी बताइए।**

**अथवा** LVDT पर टिप्पणी लिखिए।

**उत्तर** LVDT त्वरणमापी रेखीय वोल्टेज विभेदी ट्रांसफॉर्मर (linear voltage transformer) पर आधारित होता है। LVDT की प्राइमरी कुण्डल P पर ए.सी. इनपुट दिया जाता है। सेकण्डरी कुण्डली S<sub>1</sub> तथा S<sub>2</sub> को एक-दूसरे के विपरीत श्रेणिक्रम में जोड़ दिया जाता है जिसके फलस्वरूप सेकण्डरी कुण्डलियों के सिरो पर विभेदी वोल्टेज आउटपुट प्राप्त होता है।

LVDT त्वरणमापी का कोर (core) सीमिक द्रव्यमान की तरह कार्य करता है। कोर, हाउसिंग फ्रेम से जुड़ी दो रीड (reed) के सहारे टिका रहता है। कोर के लिए स्प्रिंग का कार्य रीड द्वारा किया जाता है। रीड हाउसिंग फ्रेम पर लगी रहती है। फ्रेम कम्पन करने वाले अवयव पर दृढ़तापूर्वक लगा दिया जाता है। रीड को फ्रेम पर इस प्रकार लगाया (fix) जाता है कि कोर शून्य विक्षेप (null deflection) की स्थिति में रहे जिससे कि विभेदी आउटपुट वोल्टेज का मान शून्य रहता है। जब कम्पन, हाउसिंग के द्वारा रीड से होते हुए कोर तक पहुँचते हैं तो कोर विस्थापित होता है। माना कोर किसी क्षण S<sub>1</sub> की ओर विस्थापित है तो सेकण्डरी S<sub>1</sub> का वोल्टेज (E<sub>1</sub>) बढ़ जाता है तथा तदनुगत में सेकण्डरी S<sub>2</sub> का वोल्टेज (E<sub>2</sub>) घट जाता है। दोनों सेकण्डरी के सिरो पर विभेदी आउटपुट (E<sub>1</sub> - E<sub>2</sub>) प्राप्त होता है। इसी प्रकार उगलने ही क्षण जब कोर सेकण्डरी S<sub>2</sub> की ओर विस्थापित होता है तो E<sub>2</sub> का मान बढ़ जाता है तथा E<sub>1</sub> का मान घट जाता है और विभेदी

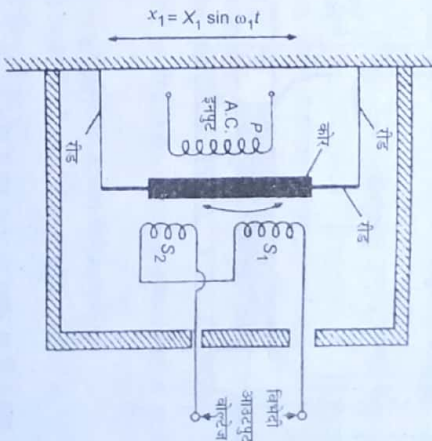


चित्र 9.2 विभवमापी त्वरणमापी

आउटपुट (E<sub>2</sub> - E<sub>1</sub>) प्राप्त होता है। विभेदी वोल्टेज का आउटपुट कम्पनों के आयाम पर निर्भर करता है। यदि (E<sub>1</sub> - E<sub>2</sub>) का मान (+ve) हो तो (E<sub>1</sub> - E<sub>2</sub>) को (-ve) माना जाता है। उच्चतम (+ve) वोल्टेज तथा उच्चतम -ve वोल्टेज का अंतर कम्पनों का आयाम दर्शाता है।

इसके लाभ निम्नलिखित हैं—

1. कोर का द्रव्यमान कम होता है; अतः इसकी स्वाभाविक आवृत्ति  $(\omega_n = \sqrt{k/M})$  अधिक होती है, इसलिए इसके द्वारा उच्च आवृत्तियों के कम्पनों का मापन संभव है।



चित्र 9.3 LVDT त्वरणमापी

2. इस त्वरणमापी में विभवमापी त्वरणमापी जैसे कोई वाइपर (wiper) युक्ति नहीं होती है। इसलिए सम्पर्क अवयव (contact element) के न होने के कारण घर्षण उत्पन्न नहीं होता।
3. स्थायी तक निम्न आवृत्ति के कम्पन मापन के लिए यह सर्वथा उपयोगी त्वरणमापी है।
4. विभवमापी त्वरणमापी की तुलना में इसमें गति के प्रति प्रतियोगी कम्पन उत्पन्न होता है।

(213)

**प्रश्न 6. पीजो-इलेक्ट्रिक त्वरणमापी की क्रिया-विधि स्पष्ट कीजिए।**

(2015, 17)

**अथवा** पीजो-इलेक्ट्रिक टाइप त्वरणमापी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

**उत्तर** जब किसी क्रिस्टल जैसे— क्वार्ट्ज, बेरियम टाइटेट को सतहों को दबाया जाता है या खींचा जाता है तो क्रिस्टल की सतहों पर आवेश आ जाता है। क्रिस्टल को एक सतह पर धनावेश तथा दूसरी सतह पर उतना ही ऋणावेश पैदा हो जाता है। इसके कारण क्रिस्टल की सतहों के मध्य वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। वोल्टेज का मान क्रिस्टल की सतह पर उत्पन्न आवेश तथा क्रिस्टल धारिता के अनुपात में बढ़ता है। इसी घटना को पीजो-इलेक्ट्रिक प्रभाव कहते हैं। यदि क्रिस्टल की सतह पर F बल लगाने पर Q आवेश उत्पन्न होता है तो

$$Q = qF$$

जहाँ, q क्रिस्टल के लिए एक नियतांक है जिसे क्रिस्टल की आवेश संवेदता कहते हैं। पीजो-इलेक्ट्रिक त्वरणमापी में क्रिस्टल की सतह पर भूकम्पी द्रव्यमान M रख दिया जाता है। सीमिक द्रव्यमान एक क्लिप स्प्रिंग की सहायता से हाउसिंग फ्रेम व क्रिस्टल के मध्य स्थिर रहता है। कम्पन होने पर क्लिप स्प्रिंग में विक्षेप उत्पन्न होगा तो द्रव्यमान क्रिस्टल दबायेगा जिसके फलस्वरूप क्रिस्टल की सतहों के मध्य वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है।

कम्पनों के कारण, भूकम्पी द्रव्यमान M क्रिस्टल पर परिवर्तनीय (variable) बल F आरोपित करता है। यदि कम्पनों का परिवर्तनीय त्वरण a है तो

$$F = Ma$$



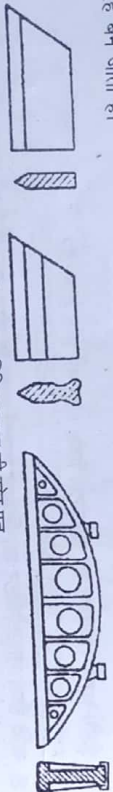
प्रश्न 2. सीधेपन का मापन कितने प्रकार से किया जाता है? किसी एक का वर्णन कीजिए।

(2015)

अथवा सीधेपन जाँच पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।  
सीधेपन का मापन निम्न युक्तियों से किया जाता है—

1. स्ट्रेट एज (Straight edge),
2. स्पिरिट लेवल या ऑटोकॉलिमिटर (Spirit level or autocollimator),
3. स्लिप गेज वेज द्वारा (By slip gauge wedge)।

**स्ट्रेट एज विधि** Straight Edge Method स्ट्रेट एज हार्ड स्टील का लैस (hardened and lapped steel) का बना हुआ एक लम्बा मापन यंत्र होता है जिसका सेक्शन पतला तथा गहरा होता है। स्ट्रेट एज के किनारों पर छोटी जिंखा बना दी जाती है। ऐसा करने से एज के किनारों की तीक्ष्णता समाप्त हो जाती है। इस प्रकार स्ट्रेट एज एक ब्लैंड धार की चाकू की तरह बन जाता है।



चित्र 10.1 विभिन्न प्रकार की स्ट्रेट एज

स्ट्रेट एज को किसी सतह पर रखकर प्रकाश की विपरीत दिशा में देखकर सतह की स्ट्रेटनेस (सीधेपन) का अनुमान लगाया जा सकता है। स्ट्रेट एज की यथार्थता (accuracy) उच्च होनी चाहिए। किसी स्ट्रेज एज का अधिकतम विचलन नीचे दिए गए मान से अधिक नहीं होना चाहिए—

$$\pm \left( 0.001 + \frac{L}{500000} \right) \text{ mm}$$

जहाँ L स्ट्रेट एज की लम्बाई (mm) है।  
बड़ी स्ट्रेट एज को लम्बाई (mm) है।  
बड़ी स्ट्रेट एज को परवलयाकार इसलिए बनाया जाता है जिससे कि प्रत्येक बिन्दु का नमन इसके धार के कारण उत्पन्न नमन आघूर्ण (Bending moment) के समानुपाती रहे। बड़ी स्ट्रेज एज न्यूनतम विक्षेप वाले बिन्दुओं (points of minimum deflection) पर समोद की जानी चाहिए। यह बिन्दु स्ट्रेज एज पर तीर से दर्शाए गए रहते हैं तथा वे 0.544 L दूरियों पर स्थित होते हैं।

अधिकतर मामलों में स्ट्रेट एज को समतल सतह पर रखकर प्रकाश के विपरीत देखा जाता है। यदि जाँची जाने वाली सतह पूर्ण रूप से सीधी है तो प्रकाश नहीं दिखेगी। पड़ना, परंतु यदि समतल तथा स्ट्रेट एज के मध्य गैप है तो प्रकाश के विचलन (diffraction) के कारण लाल या नीला प्रकाश दिखायी पड़ेगा। यदि लाल रंग का प्रकाश दिखायी पड़ता है तो समतल तथा स्ट्रेट एज के मध्य लगभग 0.1 μm से 1.5 μm के मध्य है। यदि नीले रंग का प्रकाश दिखायी पड़ता है तो समतल तथा स्ट्रेट एज के मध्य लगभग 0.5 μm का गैप होता है।

प्रश्न 3. ऑटोकॉलिमिटर की रचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए।

(2015)

अथवा स्वचालित-कोलिमिटर की कार्य-विधि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

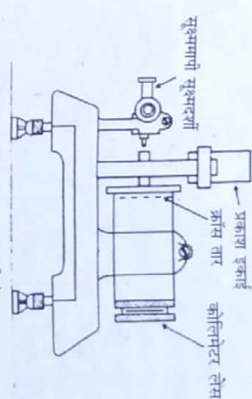
(2016, 17)

उत्तर ऑटोकॉलिमिटर की रचना इनमें में एक टयूब होती है जिससे प्रकाश की समान्तर किरणें प्रकाश स्रोत से डाली जाती हैं। इसके साथ एक सूक्ष्मदर्शी या टेलिस्कोप (telescope) लगा होता है जिसके आई-पीस में सूक्ष्ममापी या माइक्रोमीटर लगा होता है। यंत्र में प्रकाश का एक स्रोत भी लगा होता है। चित्र 10.2 में इसका आरेख दिखाया गया है।

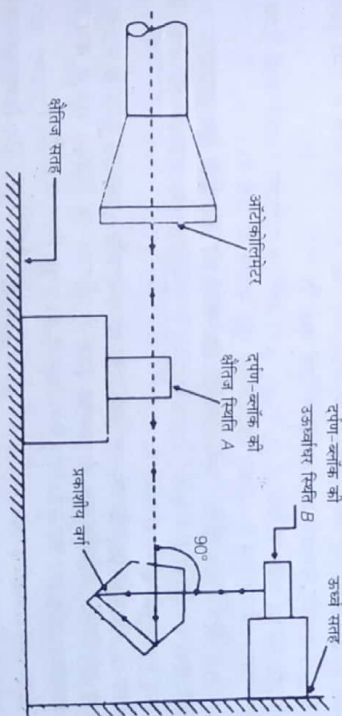
इस यंत्र का प्रकाशीय प्रबन्ध (optical system) चित्र 10.2 में दिखाया गया है। यंत्र की अक्ष पर लगे अभिदृश्य (objective) के फोकल-बिन्दु पर लक्ष्य-तार लगा होते हैं। इनके पीछे एक परावर्तक लगा होता है जिसके ऊपर प्रकाश

स्रोत से पड़ने वाला प्रकाश 90° पर परावर्तित होता जाता है

परन्तु क्षैतिज प्रकाश इसमें गुजर सकता है। प्रकाश स्रोत से निकलने वाला प्रकाश इस पर फोकस होता है और परावर्तित होता है जिससे क्रॉस-वायर प्रकाश-मान हो जाती है और इनका विन्ध दाहिनी ओर चलता है तथा समान्तरण के कारण अभिदृश्यक से होकर प्रकाश के समान्तर पुंज के रूप में निकलता है। एक अन्य परावर्तक पर टकराने के बाद निम्न परावर्तित होकर पुनः फोकल प्लेन (focal plane) में परावर्तित होकर पुनः फोकस (eye piece) में फोकस हो जाता है। माइक्रोस्कोप से देखने पर मूल क्रॉस-वायर भी दिखाई देते हैं। यदि परावर्तित विन्ध अपने मूल मार्ग से बापस आता है तो वह मूल विन्ध का समान्ती (coincident) होगा और केवल एक क्रॉस-वायर (cross wire) दिखायी देगी। परन्तु यदि परावर्तक सतह (reflection surface) कुछ तिरछी या झुकी हुई है तो परावर्तित विन्ध केन्द्रीय स्थिति से हट कर बनेगा और माइक्रोस्कोप में दो क्रॉस-वायर दिखायी देंगे जिनमें एक मूल क्रॉस वायर होगा और दूसरा उसका विस्थापन विन्ध होगा। दोनों क्रॉस-वायरों के बीच दूरी मापन के लिए माइक्रोमीटर, विन्यास में एक जोड़ी सेटिंग लाइनें (setting lines) लगी होती हैं।



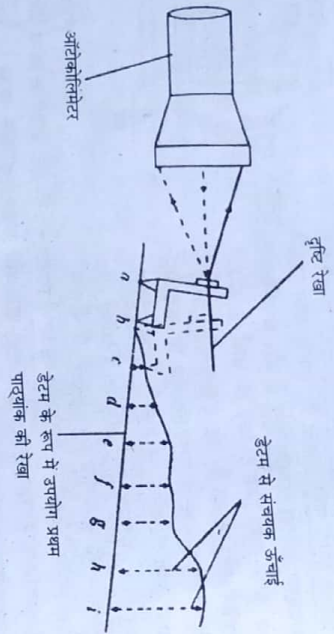
चित्र 10.2 ऑटोकॉलिमिटर



चित्र 10.3

माइक्रोमीटर पैमाने के साथ एक अंशिकन प्रबन्ध (calibration system) भी लगा होता है जिससे एक विभाजन अर्थात् 10 सेकण्ड चाप के लिए आनत कोण (angle of inclination) का मान पढ़ा जा सकता है। यह यन्त्र द्वारा लगभग दो मीटर की दूरी तक स्थापित परावर्तक सतह के विन्ध को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसमें लगभग 20 तक के आनत कोण पढ़ने की क्षमता होती है।

**ऑटोकॉलिमिटर की कार्यविधि** इस विधि के अन्तर्गत, जिस सतह की जाँच करनी हो, उस सतह से लगभग 50 से 75 सेमी की दूरी पर एक दृढ़ आधार पर ऑटोकॉलिमिटर को रखा जाता है। फिर इस सतह की लम्बाई में कोलिमिटर से प्रकाश की समान्तर पुंज (parallel beam) प्रक्षेपित (project) की जाती है। एक ब्लॉक जिसमें एक समतल ऊर्ध्वाधर परावर्तक लगा होता है, सतह पर रखा जाता है और ब्लॉक की परावर्ती सतह यन्त्र के सामने रखी जाती है। परावर्तक और यन्त्र इस प्रकार सेट किये जाते हैं कि कोलिमिटर के क्रॉस-वायरों का विन्ध क्षेत्र के निकट प्रतीत होता है और सतह की सरल रेखा पर परावर्तक के लिए क्रॉस-वायरों का विन्ध आई-पीस के क्षेत्र में दिखाई देगा। अब परावर्तक को सतह पर स्थित दूरी के अन्तर्गत में हटा-हटा कर सतह की सीधेपन की जूट आई-पीस से सेकण्डों के मान में नोट की जाती है।



चित्र 10.4

चाप पर 1 सेकण्ड = 0.000006 मिमी (शुकाव)। यदि कोलिमेटर के विस्थापन का अन्तराल 1 हो तो सेकण्ड चाप (arc) के लिए सतह का उतार या चढ़ाव  $0.000006 \times 1$  मिमी होगा।

चित्र 10.4 में अंतिकोलिमेटर से सतह की जाँच का प्रबन्ध दिखाया गया है, इसमें परावर्तक की स्थिति (a-b) द्वारा दिखायी गयी है। इस स्थिति पर अंतिकोलिमेटर के माइक्रोमीटर की सीडिंग पढ़ी जाती है। इसी प्रकार सतह की पूरी लम्बाई में b-c, c-d आदि स्थितियों के लिए सीडिंग देखी जाती है।

पाठ्यांक में शुटि को दूर करने के लिए (i-h), (h-g), (g-h) आदि पर परावर्तक रखकर उल्टी दिशा में पाठ्यांक पढ़े जाते हैं। इस प्रकार आसत मान निकालकर पाठ्यांक की शुटि समाप्त हो जाती है।

#### प्रश्न 4. समतलता की परिभाषा दीजिए। समतलता शुटि ज्ञात करने की विधियों के नाम बताइए।

**उत्तर** किसी सतह को समतलता से तालचर्म समान्तर समतलों के युग्म के अधिकतम संयोजन (स्पर्श) से है जिसमें सतह के सभी बिन्दु एक-दूसरे को स्पर्श करते हैं।

भारतीय मानक IS : 2063-1962 के अनुसार किसी सतह को तभी प्लैट (समतल) कहा जा सकता है जब सतह के सभी बिन्दुओं की किसी ज्यामितीय तल से लम्बवत् दूरियों में परिवर्तन एक निश्चित मान से कम हो।

सतह की समतलता शुटि ज्ञात करने के लिए निम्न विधियों का प्रयोग किया जाता है।

- (i) सम्पर्क द्वारा (By contact),
- (ii) बीम तुलनित्र द्वारा (By beam comparator),
- (iii) बार तुलनित्र द्वारा (By bar comparator) तथा
- (iv) डायल गेज द्वारा (By dial gauge)।

#### प्रश्न 5. समतलता शुटि मापन की किन्हीं दो विधियों का वर्णन कीजिए।

**अथवा** समतलता की जाँच करने की विधि का उल्लेख कीजिए।

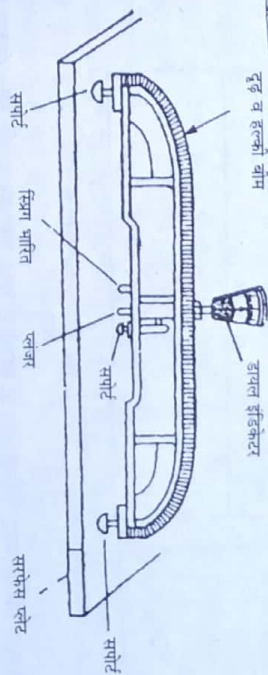
**उत्तर 1.** सम्पर्क द्वारा समतलता शुटि का मापन Measurement of Flatness Error by Contact सरफेस प्लेट विभिन्न आकारों तथा प्रकार की बनायी जाती है। कार्यशाला की आवश्यकता के अनुसार इन्हें डिजाइन किया जाता है। सरफेस प्लेट तैप किए गए हार्ड कास्ट आयरन से बनी होती है। तैपिंग के स्थान पर सरफेस प्लेट स्क्रैपिंग से भी बनायी जाती है। सरफेस प्लेट इस प्रकार प्रसैट बनायी जाती है कि सतह पर किसी प्रकार की शुटि न रहे।

सरफेस प्लेट ग्रेड-I तथा ग्रेड-II में विभिन्न नाणों की उपलब्ध रहती है।  $250 \times 250$  mm नाप की ग्रेड-I सरफेस प्लेट की अधिकतम प्रसैटनेस शुटि 0.005 mm, इसी नाप की ग्रेड-II प्लेट की प्रसैटनेस शुटि 0.020 mm तक हो सकती है।

सरफेस प्लेट को प्रसैटनेस शुटि ज्ञात करने के लिए इस सतह पर 'प्रुसियन ब्लू' (Prussian blue) लगा दिया जाता है। प्रुसियन ब्लू, नीले रंग का गाढ़ा-सा पेस्ट होता है जो बाजार में ट्यूब के रूप में उपलब्ध रहता है। ब्लू लगाने के पश्चात् सरफेस प्लेट के ऊपर अन्य सतह रखकर दोनों को रगड़ा जाता है। इस प्रकार सरफेस के उच्च बिन्दुओं

(high points) पर ब्लू लगा जाता है तथा निम्न बिन्दुओं पर ब्लू नहीं लगाता है। इससे सतह की अवतलता तथा उतलता का गुणात्मक अनुमान लगा जाता है।

2. **तुलनित्र द्वारा समतलता का मापन** Measurement of Flatness Error by Beam Comparator सतह को प्रसैटनेस शुटि ज्ञात करने के लिए बीम तुलनित्र (beam comparator) का प्रयोग बहुधा किया जाता है। बीम तुलनित्र चार बिन्दुओं पर टिका रहता है। बीम तुलनित्र किनारों पर दो स्थिर बिन्दु तथा मध्य में दो बिन्दुओं पर टिका रहता है। चार बिन्दुओं पर टिकारो के बिन्दु को मिलाने वाली रेखा से ऑफसेट (offset) होते हैं। इनमें से एक स्थिर तथा एक मध्य के दो बिन्दु किनारों के बिन्दु को मिलाने वाली रेखा से ऑफसेट (offset) होते हैं। इनमें से एक स्थिर तथा एक भागित स्थिर के सहारे टिका रहता है। इस प्रकार एक बीम तुलनित्र तीन प्राय हो जाता है तथा प्रसैटनेस शुटि इसी प्लेन के संदर्भ में ज्ञात रहता है। तीन स्थिर बिन्दुओं को मिलाने पर संदर्भ प्लेन प्राय हो जाता है तथा प्रसैटनेस शुटि इसी प्लेन के संदर्भ में ज्ञात की जाती है। बीम तुलनित्र के मध्य में डायल गेज लगाया जाता है। सरफेस प्लेट पर बीम तुलनित्र को रखने के बाद डायल को शून्य कर लेने पर चारों बिन्दु एक ही तल पर आ पाते हैं।



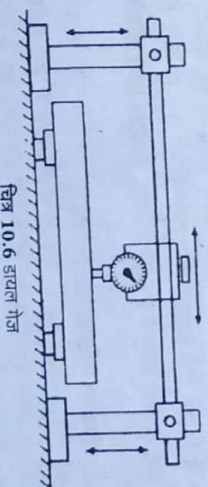
चित्र 10.5

बीम तुलनित्र को पहले से ही चिह्नित की गयी रेखाओं पर रखा जाता है और डायल गेज की सीडिंग नोट कर ली जाती है। डायल गेज संदर्भ तल के सापेक्ष अवतलता अथवा उतलता की माप देता है। अंत में उपरोक्त विधि से प्राय मानों की गणना कर ली जाती है।

#### प्रश्न 6. डायल गेज द्वारा समतलता शुटि के मापन की विधि को सचित्र स्पष्ट कीजिए।

**उत्तर** सरफेस प्लेट की प्रसैटनेस की जाँच करने के लिए प्लेट को किसी बड़ी संदर्भ सतह पर स्थिर गेज या स्क्रू जैक के सहारे रखा जाता है जिससे कि दोनों सतहें समान्तर रह सकें। सीडिंग लेने के लिए डायल गेज का प्रयोग किया जाता है जिसका स्टैड संदर्भ सतह पर रखा होता है। डायल गेज को ब्रिज के ऊपर लगाया जाता है जिससे पूरी सतह की सीडिंग आसानी से ली जा सके।

सम्पूर्ण सतह को रेखाओं के ग्रिड (grid : जाल) द्वारा बाँट दिया जाता है। डायल की सहायता से प्रत्येक प्रतिच्छेद बिन्दु की सीडिंग पढ़ ली जाती है। इन सभी बिन्दुओं को X-Y प्लेन पर लिख लिया जाता है। ध्यान रहे कि प्रतिच्छेद बिन्दुओं पर लिखे मान उन बिन्दुओं की ऊँचाइयों हैं, इसलिए यह मान Z-अक्ष की दिशा में हैं। अन्त में उपरोक्त की गणना कर सतह की प्लैट का मान ज्ञात कर लिया जाता है।



चित्र 10.6 डायल गेज

4	3	2	1
3	2	6	4
4	4	5	1
3	2	0	3
1	6	2	4
3	4	3	5
0	3	0	1
1	4	2	2
2	2	3	0
3	2	0	4

चित्र 10.7

प्रश्न 7. समान्तरता की परिभाषा दीजिए तथा दो सतहों के मध्य समान्तरता त्रुटि किस प्रकार ज्ञात की जाती है? वर्णन कीजिए।

(2017)

**अथवा** समान्तरता की जाँच पर संक्षिप्त नोट लिखिए।  
उत्तर 'समान्तरता' का तात्पर्य दो सतहों, दो अक्षों के समान्तर होने से है। यदि दो सतहें समान्तर हैं तो प्रत्येक बिन्दु पर दोनों सतहों के मध्य दूरी एक-समान रहेगी। परंतु यदि दोनों सतहों के मध्य दूरी लगातार बढ़ती या घटती जाए तो सतहों के मध्य समान्तरता त्रुटि या पैरालेलिज्म त्रुटि पायी जाती है।  
**दो सतहों के मध्य समान्तरता त्रुटि का मापन** दो सतहों के मध्य समान्तरता त्रुटि ज्ञात करने के लिए उनके मध्य की दूरी प्रत्येक स्थान पर ज्ञात कर ली जानी चाहिए। अधिकतम दूरी तथा न्यूनतम दूरी का अन्तर समान्तरता त्रुटि की माप होता है।



चित्र 10.8

यह जाँच करने के लिए एक डायल गेज को समतल आधार पर बाँध दिया जाता है। अब समतल आधार एक सतह पर चलाया जाता है, जबकि डायल गेज दूसरी सतह पर चलता है। दोनों सतहों के मध्य दूरी का अन्तर गेज में विक्षेप उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया में डायल गेज को दो लम्बवर्त दिशाओं में चलाया जाता है जिससे दोनों दिशाओं में समान्तरता त्रुटि ज्ञात हो जाती है।

प्रश्न 8. चौकोरपन की त्रुटि से क्या तात्पर्य है? इजीनियर्स स्क्वेअर द्वारा चौकोरपन की त्रुटि ज्ञात करने की विधि समझाइए।

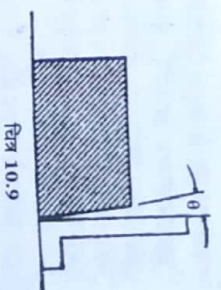
**अथवा** वर्ग-आकारता की जाँच पर संक्षिप्त नोट लिखिए।

(2016)

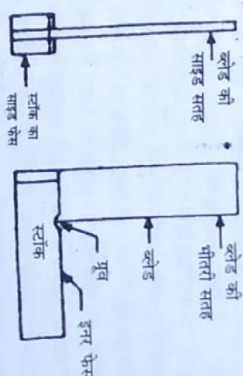
**उत्तर** चौकोरपन की त्रुटि Squareness Error यदि दो सतहें आपस में एक-दूसरे के लम्बवर्त हैं तो इसके लिए आवश्यक है कि वे सतहें किसी मानक वर्ग की सतहों के समान्तर हों। मानक वर्ग के रूप में ऑप्टिकल वर्ग या समकोण लेवल का प्रयोग किया जाता है। चौकोरपन की त्रुटि अवयव के नापे गए कोण तथा 90° के अन्तर के रूप में व्यक्त की

जा सकती है। चौकोरपन की त्रुटि किसी दो गयी लम्बाई में डायल पर प्राप्त विक्षेप के रूप में भी व्यक्त की जाती है। चौकोरपन की त्रुटि को 'लम्बता की त्रुटि' (perpendicularity error) भी कहते हैं।

**इजीनियर्स स्क्वेअर द्वारा स्क्वेअरनेस त्रुटि का मापन** Measurement of Squareness Error by Engineer's Square इजीनियर्स स्क्वेअर में दो दृढ़ सतहें एक-दूसरे के परस्पर लम्बवर्त होती हैं। इसका ब्लेड टूल स्टील या प्लैतीय स्टील का बना होता है जिसके दोनों किनारे 60° पर तिरछे रहते हैं। ब्लेड कार्ट स्ट्रोल के स्टॉक के साथ रिबेट के माध्यम से जुड़ा रहता है। सामान्यतः स्टॉक, ब्लेड की तुलना में मोटा रहता है।

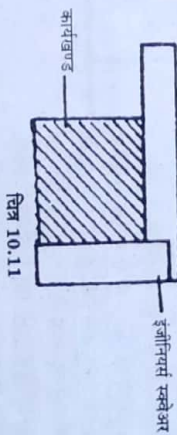


चित्र 10.9



चित्र 10.10 इजीनियर्स स्क्वेअर

I.S.: 2103-1972 के अनुसार इजीनियर्स स्क्वेअर के तीन ग्रेड होते हैं। ब्लेड की मानक लम्बाई 50, 100, 150, 200, 300, 500, 700 तथा 1000 mm तक होती है। किसी वर्गाकार सतह की लम्बता की जाँच करने के लिए इजीनियर्स स्क्वेअर के ब्लेड तथा स्टॉक को लम्बवर्त सतहों के ऊपर रख देते हैं। यदि सतहें लम्बवर्त हैं तो प्रकाश में देखने पर गैप नहीं दिखायी पड़ता है, परंतु यदि दिखायी पड़ता है तो फिलर गेज की सहायता से गैप ज्ञात कर लिया जाता है। नापी गयी लम्बाई तथा गैप से कोण निकाल लिया जाता है। यह कोण 90° के सापेक्ष त्रुटि प्रदर्शित करता है। इजीनियर्स स्क्वेअर की सहायता से किसी सतह के सीधेपन की भी जाँच की जा सकती है।

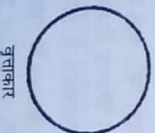


चित्र 10.11

प्रश्न 9. वृत्तीयता त्रुटि से क्या तात्पर्य है? इसके प्रमुख कारण बताइए।

**अथवा** ज्यामितीय सफूर्तारिटी पर टिप्पणी लिखिए।

**उत्तर** गोलीय कार्यखण्डों की ऐसेब्लनी में उनके व्यास का माप या टॉलरेस ही फिटमेंट को प्रभावित नहीं करते हैं वरन् व्यास के अतिरिक्त गोलीय बेलनाकार अवयव की ज्यामितित भी फिटमेंट को प्रभावित करती है। किसी कार्यखण्ड की वृत्तीयता गोले होने की यथार्थता तथा उसकी बेलन की प्रोफाइल फिटमेंट को व्यापक रूप से प्रभावित करते हैं। यदि किसी बेलनाकार अवयव की माइक्रोमीटर से नापा जाता है और अवयव की माप टॉलरेन्स के भीतर आती है, फिर भी यह संभव है कि अवयव पूर्ण रूप से गोला (circular) न हो। यह समस्या फिटमेंट के समय आती है। चित्र 10.12 में बेलनाकार अवयव की वृत्तीयता त्रुटि को दर्शाया गया है।



वृत्ताकार



3 लीबेरा



7 लीबेरा

वृत्तीयता त्रुटि के प्रमुख कारण निम्न हैं—

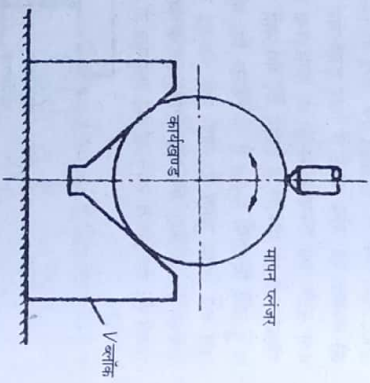
- (i) कार्यखण्ड को पकड़ने के कारण उत्पन्न विरूपण (clamping distortion),
- (ii) मशीन स्मिडल का रनआउट,
- (iii) कार्यखण्ड की सतह व जॉ (jaw) के मध्य चित्र या गंदगी का होना,
- (iv) स्मिडल की वियरिंग खराब होना (run out),
- (v) स्टेजों की कमी होना,
- (vi) मशीन में कामन होना,
- (vii) कटिंग प्रक्रिया में समरूपता न होना,
- (viii) केन्द्रकों का संरेखन ठीक से न होना,
- (ix) फीट/डेप ऑफ कट अधिक होना,
- (x) अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होना,
- (xi) सेटर्नलैस ग्राइंडिंग सक्रियता।

### प्रश्न 10. V-ब्लॉक द्वारा गोलीयता जात करने की विधि का वर्णन कीजिए।

**उत्तर** जिस अवयव की गोलीयता जाँची होती है, उसे साफ करके V-ब्लॉक के ऊपर रख देते हैं। तत्पश्चात् 0.001 mm सूक्ष्मता का डायल इंडिकेटर अवयव पर स्पर्श करा देते हैं। अब अवयव को V-ब्लॉक के ऊपर घुमाते हैं और डायल के ऊपर जाने व नीचे आने की मात्रा को नोट कर लेते हैं।

अवयव की 'लोब' की संख्या जात करने के लिए उसे पहले 60° V-ब्लॉक पर फिर 90° V-ब्लॉक पर घुमाते हैं। अब जितनी बार डायल सूचक में विक्षेप उत्पन्न होता है, अवयव के लोब की संख्या जात हो जाती है। इसका कारण यह है कि 60° V-ब्लॉक, ओवल अवयव के लिए विक्षेप नहीं प्रदर्शित करता है; जबकि 90° V-ब्लॉक ओवल अवयव के लिए दो बार उच्च तथा दो बार निम्न मान प्रदर्शित करता है। डायल का कुल विक्षेप गोलीयता त्रुटि प्रदर्शित करती है।

**अतः स्पष्ट है कि एक ही अवयव विभिन्न कोण के V-ब्लॉक पर अलग-अलग मान प्रदर्शित करता है। इस त्रुटि से बचने के लिए 2 बिन्दु लोब के लिए (ओवल अवयव) 90° का V-ब्लॉक, 3 बिन्दु लोब के लिए (त्रिभुजाकार) 60° का V-ब्लॉक, 5 बिन्दु लोब के लिए 108° का V-ब्लॉक तथा 7 बिन्दु लोब के लिए 128° 34' का V-ब्लॉक प्रयोग करना चाहिए। हालाँकि इनके सारे V-ब्लॉक उपलब्ध कर पाना कभी-कभी कठिन होता है, इसलिए समायोज्य V-ब्लॉक (adjustable V-block) एक अच्छा उपाय है।**



चित्र 10.13

### प्रश्न 11. टेलर हॉबसन टेलीरेड उपकरण की रचना तथा इसके द्वारा वृत्तीयता जात करने की विधि समझाइए।

**उत्तर** रचना Construction इस यन्त्र में उच्च यथाशक्ती का सूक्ष्म स्मिडल (precision spindle) होता है तो अपनी अक्ष के प्रति: घूमता है। इसकी अनुमत असंकेन्द्रित (permissible eccentricity) 0.01 μm से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस स्मिडल पर एक हीरेक बिन्दु स्टाइलस (diamond point stylus) के साथ एक स्टाइलस भुजा इस प्रकार लगी होती है कि स्मिडल की घुमाऊ अक्ष से स्टाइलस की स्थिति परीक्षण किए जाने वाले अवयव की त्रिज्या के अनुसार परिवर्तित हो सके। स्मिडल ऊपर एवं नीचे गति कर सकता है ताकि अवयव की विभिन्न ऊँचाइयों के लिए मापन किया जा सके। इससे परीक्षण किए अवयव के सीधेन की भी जाँच हो जाती है। जाँच को समायोजी टेबल की सहायता से कोट्रल कर लिया जाता है ताकि स्मिडल की अक्ष जाँच की अक्ष के संपाती हो जाए।

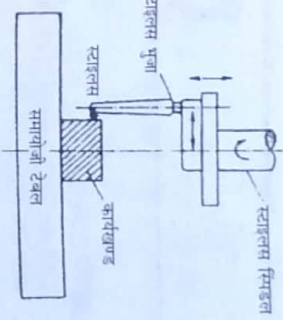
**वृत्तीयता जात करने की विधि** स्मिडल को घुमाकर डायमण्ड स्टाइलस के द्वारा परीक्षण किए जाने वाले अवयव के संदर्भ में एक यथार्थ वृत्त बना लिया जाता है। यदि अवयव पूर्णतया गोल है, तो स्टाइलस रैडियक विस्थापित (radially displaced) नहीं होगा। वास्तविक कन्टूर के यथार्थ वृत्त से यदि कोई विचलन है तो स्टाइलस में रैडियक गति होगी। स्टाइलस की यह गति स्टाइलस भुजा में लगे दो इन्डक्टिव अवयवों (inductive elements) के द्वारा विद्युत सिगनल (electrical signals) में परिवर्तित हो जाती है। ये विद्युत सिगनल आवर्धित होकर ध्रुवीय कोऑर्डिनेट रिकॉर्डर (polar coordinate recorder) पर रिकॉर्ड हो जाते हैं। इस ध्रुवीय रिकॉर्डर के चक्र मशीन स्मिडल से समकालिक होते हैं। इस

प्रकार एक ध्रुवीय ग्राफ सीधे प्राप्त किया जा सकता है। इस ध्रुवीय ग्राफ के द्वारा यह जात किया जा सकता है कि परीक्षण किए जाने वाले जाँच की परिधि, वास्तविक वृत्तीय आकृति से कितनी अलग है। स्टाइलस गति के विद्युत आवर्धन (electrical magnification) को एक लाख गुना तक बढ़ाया जा सकता है।

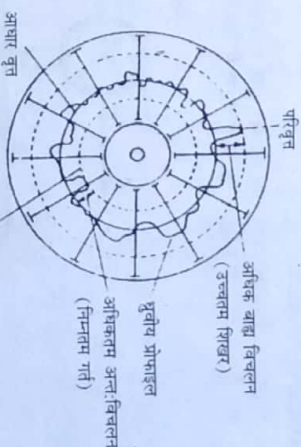
गोलाई परीक्षण, कार्यखण्ड को आन्तरिक तथा बाह्य सतह के परिष्माण के लिए किए जा सकते हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि स्टाइलस गति को अत्यधिक आवर्धित किया जा सकता है, इस कारण मैक्रो (macro) तथा माइक्रो (micro) अनियमितताएँ (irregularities), कार्यखण्ड को अक्ष के सापेक्ष रिकॉर्डेड ध्रुवीय ग्राफ पर देखा जा सकता है। माइक्रो अनियमितताएँ (सतह रूक्षता) की विद्युतीय फिल्टर (electrically filter) करके अवयव की गोलाई की त्रुटि का अकेले मापन किया जा सकता है। चित्र 10.14 में दिखाए गए टेलीरेड प्रोफाइल ग्राफ से गोलाई की त्रुटि निम्न प्रकार से ध्रुवीय ग्राफ (polar graph) बनाकर मापी जा सकती है—

कार्यखण्ड की आदर्श स्थिति के लिए उस पर एक आधार वृत्त बनाया जाता है। इस डेटम वृत्त को पूरी परिधि को 12 समान रूप से विभाजित किया जाता है। इसके बाद प्रोफाइल ग्राफ की अधिकतम बाहरी स्थिति के लिए उसी केन्द्र से एक वृत्त खींचा जाता है तथा अधिकतम भीतरी स्थिति के लिए भी उसी केन्द्र से एक अन्य वृत्त खींचा जाता है। इन वृत्तों का न्यूनतम रैडियक अन्तर गोलाई त्रुटि का माप होता है।

टेलीरेड यन्त्र अत्यधिक उपयोगी यंत्र है। इसका उपयोग वियरिंग बनाने वाली कैस्टरियों में क्रैक पिन, पिस्टन पिन इत्यादि की जाँच में बहुत होता है।



चित्र 10.14 टेलीरेड विधि



चित्र 10.15 टेलीरेड ग्राफ